

2024 年 9 月 2 日

致各位

公司名：尼得科精密检测科技株式会社
代表人：总裁 山崎 秀和
公司地址：京都府向日市森本町东之口 1-1 Nidec
Park C 栋
联系电话：075-280-8100

尼得科精密检测科技将参展 SEMICON TAIWAN 2024

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参展 2024 年 9 月 4 日(周三)～9 月 6 日(周五)于台北南港会展中心举办的“SEMICON TAIWAN 2024”，该展会是展示半导体行业前沿技术和创新成果的亚洲最大规模的国际展会之一。



该展会是台湾颇具影响力的半导体行业展会，今年的主题为“BREAKING LIMITS: POWERING THE AI ERA.”，预计有超过 1,100 家企业参展。

预计未来人工智能半导体相关产品的市场需求将大幅增长，其微型化和安装复杂性也在不断增加，因此需要新的检测技术来应对这一趋势。

尼得科精密检测科技将以“TEST SYSTEM ONE STOP SOLUTIONS”为主题，介绍公司引以为豪的光学检测技术、电气检测技术、探测技术，并且为尖端半导体封装的晶圆、芯片、基板及封装等所有工序提供优秀的检测解决方案。此外，还将介绍最近备受行业关注的功率半导体的前沿技术和产品。

〈参展概要〉

- 会期：2024 年 9 月 4 日(周三)～9 月 6 日(周五)
- 会场：台湾台北南港会展中心（TaiNEX 2）
- 展位：Hall2 Q5652

〈参展内容〉

- 高精度光学式晶圆检测装置“NSW 系列”
- 支持晶圆凸块的光学式 2D/3D 检测装置“RWi 系列”
- 最多可支持 60 层的“空间转换器 MLO”

- 高精度、降低噪音影响的“2D MEMS 探针卡”
- 可支持 $-40^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$ 测量的“TC 探针”
- 可支持尖端半导体设备最小凸点间距 $60\text{ }\mu\text{m}$ 的“MEMS FLEX 探针卡”
- 可支持高电压、高温环境的“腔室头（Chamber Head）探针卡”
- xEV 建模模拟器“E-Transport Simulator”

今后，尼得科精密检测科技将不断加快运用了检测装置技术的各类产品的自主制造，通过实现包括电机节能化在内的系统整体优化来提高用电效率，为客户提供有益于降低地球环境负荷的创新型解决方案。